

2023年5月24日

各 位

会 社 名 株式会社 ブイ・テクノロジー  
 代 表 者 代表取締役 兼 社長執行役員 杉本 重人  
 (コード番号：7717 プライム市場)  
 問 合 せ 先 社長室 IR グループ長 吉村 省吾  
 (TEL：045-338-1980)

### 子会社(合弁会社)の設立に関するお知らせ

株式会社ブイ・テクノロジー（本社：神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町134横浜ビジネスパーク イーストタワー9F 代表取締役 兼 社長執行役員 杉本 重人、以下「当社」）は、株式会社 EORIC（本社：東京都新宿区市谷八幡町2-1、代表取締役 CEO 李 梶、以下「EORIC 社」）との合弁により株式会社 LE-TECHNOLOGY（読み：エルイーテクノロジー、本社：東京都、代表取締役社長：李 梶）を設立いたしましたので下記にお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 目的・背景

社会のデジタル化を背景に、高精度プリント基板市場のさらなる拡大が予想されており、高度化するプリント基板を製造するお客様に革新的な露光技術をいち早くご提供するべく、高精細ダイレクトイメージング装置事業(以下、高精細 DI\*1)を主業とする新会社を、EORIC 社と設立いたしました。

合弁相手先の EORIC 社は、高精細化する電子回路の撮像に対応する観察光学系、LED・ランプ光源を最大限に有効活用する照明光学系、偏光や干渉を考慮したレーザー光学系等において多数の実績と知見を有する企業であり、当社の技術開発のパートナーです。

#### 2. 子会社の概要

(単位:百万円、特記しているものを除く)

(1)名称	株式会社 LE-TECHNOLOGY		
(2)本社所在地	東京都新宿区市谷八幡町2-1		
(3)代表者の役職・氏名	代表取締役社長 李 梶		
(4)事業内容	ダイレクト露光装置、電子回路の検査装置および測定装置の開発、設計、製造、販売等		
(5)資本金	500 百万円*2		
(6)設立年月日	2023 年 4 月 28 日		
(7)決算期	3 月		
(8)出資比率	ブイ・テクノロジー：80%、EORIC：20%		
(9)3 年間の経営成績および財政状況の予想*2	2024 年 3 月期	2025 年 3 月期	2026 年 3 月期
純資産	900	2,160	3,620
総資産	1,300	2,630	4,080
一株当たり純資産(円)	50,000	120,000	201,111

売上高	810	3,090	7,220
営業利益(▲は損失)	▲180	500	1,450
(10)当社との関係	資本関係	当社は 80%を出資します。	
	人的関係	取締役を派遣しています。	
	取引関係	該当事項はありません。	
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。	

3. 合弁相手先の概要 (単位:千円、特記しているものを除く)

(1)名称	株式会社 EORIC (読み方:イオリック)		
(2)本社所在地	東京都新宿区市谷八幡町 2-1		
(3)代表者の役職・氏名	代表取締役 CEO 李 梶		
(4)事業内容	光学技術関連の設計、開発業務、自社開発製品のユニット販売、他		
(5)資本金	52 百万円		
(6)設立年月日	2018 年 8 月 1 日		
(7)大株主および持ち株比率	李 梶: 47.3% (株)ブイ・テクノロジー: 25.3% 田巻 純一: 20.2%		
(8)3 年間の経営成績および財政状況	2020 年 6 月期	2021 年 6 月期	2022 年 6 月期
純資産	94,062	98,663	137,235
総資産	137,923	314,901	435,140
一株当たり純資産(円)	3,594	3,770	4,774
売上高	345,867	403,083	727,101
営業利益	27,809	705	37,286
経常利益	28,618	2,609	34,652
当期純利益	18,987	4,600	24,769
一株当たり当期純利益(円)	725	175	861
(9)当社との関係	資本関係	当社は 25%を出資、持ち分法適用会社となります。	
	人的関係	該当事項はありません。	
	取引関係	当社グループの技術開発等を委託しております。	
	関連当事者への該当	該当事項はありません。	

#### 4. 日程

子会社設立の取締役会決議日：2023年4月28日

子会社設立日：2023年4月28日

子会社における増資の決議日：2023年5月18日

#### 5. 今後の見通し

子会社の設立に伴う2024年3月期の当社連結業績予想に与える影響は軽微であり、同期の当社業績予想に織り込まれています。開示すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

今後は、人財提供や技術開発、そして生産・調達、アフターサービス体制等の提供などを通じて、多方面で同社の経営をリードし、高精細DIのPCB分野での更なる普及と拡販を積極的にサポートいたします。

さらに、両社の技術的強みのシナジー効果により、さらなる高精度化が進むアドバンスドパッケージ分野、ならびに次なる技術トレンドであるChiplet分野でダイレクト露光装置のリーディングカンパニーを目指します。

##### \*1 DI(Direct imaging)

高出力レーザーで回路パターン等のCADデータを感光性樹脂(フォトレジスト)に直接描画する技術で、フォトマスクを使わずに露光ができ、省工程な製造プロセスの設計、多品種少量生産の全自動化、短納期化、低コスト化を実現する技術です。近年では生産能力が劇的に向上し、高精度PCBの大規模生産ラインへの採用が始まっています。

##### \*2 子会社の資本金

設立時100百万円、5月18日増資後に500百万円となっております。

##### \*3 上記の見通し・予想など将来事象等

本資料発表現在、当社が入手可能な情報に基づいて作成しております。さまざまな不確定要素が内在されており、実際の業績は種々の要素により業績予想とは異なる場合があることをご承知おきください。

以上